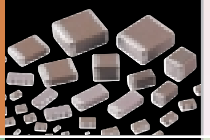
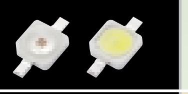
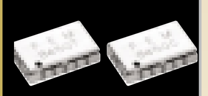
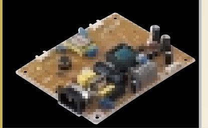
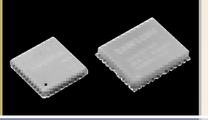
JOB SPECIFICATION

| 분야 | | 기계 | 물리 | 전자전기 | 재료금속 | 화학화공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소재기술<br>Materials Technology | 기판<br> | · 열전달/유체/응력 해석<br>· 기능성 Simulation(신뢰성 평가)<br>· 가공기술(Mechanical/Laser Drill 등) | · 원자재 분석기술<br>· Embedded PCB개발 | · 전자회로<br>· CAD/CAM<br>· EMI/EMC 분석기술<br>· 반도체 제조공정/적용기술 | · Cu 도금/노광/에칭 기술<br>· 전자 Packaging기술<br>· 친환경 자재개발<br>· Stack-Via형성기술 | · 미세회로 형성기술<br>· 표면처리기술<br>· Build up기술<br>· 포토 리소그라피 형성기술 |
| | 정밀모터<br> | · 축계설계, 미세구조체설계, 진동설계, 금형설계<br>· Bearing설계, CAE성형해석기술, 실장기술<br>· 가공기술, 성형기술, 열유체해석, 구조해석<br>· 진동소음해석 | · EMI/EMC<br>· 전자기 Simulation | · 전기회로설계, 제어회로설계 | · 압전 Actuator | · 표면처리공학<br>· 부식 |
| | MLCC<br> | · Fluid Flow<br>· Heat Transfer<br>· Structural 분석<br>· 적층기술<br>· 설비 설계/해석<br>(진공, 고온, 고압, 적층, 분산<br>절단, 분쇄 기계 등)<br>· Furnace | · 고체 물리<br>· 열역학 | · 전자재료<br>· 고주파 해석/설계<br>· 신뢰성 | · Paste(Nano, Ni, Cu)<br>· 유전체 합성기술<br>· Nano 분말제조공정<br>· 무기재료<br>· 유전체 조성개발<br>· 고분자공학<br>· Sintering(소결)기술<br>· 분체특성제어(세라믹파우더)<br>· 자성체 세라믹<br>· 코팅(유전체, Metal) | · 분산기술<br>· Paste<br>· 액상법 파우더 합성<br>· 고분자, 유기화학도금<br>· Polymer합성/해석 |
| 광기술<br>Optic Technology | ISM<br> | · 기구설계<br>· 구동기구설계기술, Actuator설계<br>· 기구부품설계(Housing 설계 등) | · 렌즈설계 및 평가기술<br>· 경통설계<br>· 카메라모듈 PKG기술 | · 회로설계기술<br>· DSP회로설계(IP Core)<br>· 카메라모듈 S/W 처리기술 | · CMOS-Epoxy 및 세라믹 PCB<br>· 압전재료 | · CMOS PKG 공정기술 |
| | LED<br> | · 방열설계<br>· 광학 패키징 구조 설계<br>· 열유체해석 | · 광반도체 물성 분석<br>· 광반도체 소자 설계/분석 | · 고전력 광소자 설계<br>· 고효율 광소자 설계/분석 | · Epitaxy<br>· MOCVD 공정<br>· 패키징 재료<br>· 전극재료<br>· Nano 발광재료 | · MOCVD 공정<br>· Nano Patterning<br>· Nano 발광재료<br>· 도금/Bonding 공정 |
| RF기술<br>RF Technology | Mobile-RF<br> | · 구조기구설계, 금형(사출, 프레스) 설계,<br>정밀가공<br>· 신뢰성 평가기술 | · 전자기학<br>· 고주파공학 | · RF회로설계, Micro-strip설계, Antenna회로설계<br>· 3-D Simulation 설계기술, EMI/EMC 해석<br>· 시스템설계 및 분석기술 | · 전극재료, 세라믹 PKG설계기술, 도금기술<br>· Packaging기술, 성형기술, 적층기술, 유전체 재료<br>· 소성기술, 분산기술, 홀형성기술 | · 도금기술<br>· 반도체 공정기술 |
| | Network<br> | · 열유체해석(방열, 열 전달), PKG금형설계<br>· Metal Can설계, PKG조립기술 | · 전자기 Simulation | · 시스템구조설계, RF회로설계, 디지털회로설계<br>· 아날로그-디지털 변환설계, 통신 Protocol설계<br>· Firmware기술, OS설계, Application 설계<br>· BPF/LPF/BEF설계, S해석, MCU 응용기술<br>· Packaging기술, PCB/LTCC기술 | · Flow 솔더링기술, 고분자 재료물성평가<br>· 박막/솔더 재료평가, Bumping 재료평가<br>· 습식세정 | · 도금기술<br>· 습식세정 |
| | Power<br> | · 열전달해석 및 방열설계, 기구부품설계, 성형해석 | | · Power PCB설계, New Topology 회로 설계<br>· Hard/Soft Switching 설계기술, 다등형 동기 회로 설계기술<br>· 소신호 해석 모델링, 제어회로 설계<br>· EMI/EMC 평가 및 해석, 트랜스포머설계<br>· Power IC설계, 열설계 및 해석 | · Ferrite 소재 기술<br>(Mn-Zn, Ni-Zn)<br>· Resin 재료기술(LPC, PE)<br>· 금형설계기술<br>· 재료평가기술<br>· Soldering 기술(Flow / Reflow)<br>· 성형기술<br>· Press / 사출<br>· 도금기술(Plating) | |
| | Tuner<br> | · Chassis, Cover 류 설계<br>· 정밀부품 금형 제작/가공기술<br>· 정밀부품 조립기술 | | · LNA응용설계, Mixer설계, Oscillator설계, Filter설계<br>· IF Amp 응용설계, 아날로그-디지털 변환설계<br>· EMI/EMC해석, RF IC설계<br>· Application S/W설계, Packaging기술 | · Flow 솔더링기술, 고분자 재료물성평가<br>· 박막/솔더 재료평가, Bumping 재료평가<br>· 습식세정 | |
| 기반기술 | | · 열/유체 해석<br>· 신뢰성<br>· 구조/진동 해석 | · 광학/광소자 해석 | · 전자계/RF/회로/EMI 해석<br>· RF component/system 설계/해석<br>· Electrical simulation | · 전자부품 재료평가<br>· 고장물리<br>· 형태/성분 분석<br>· 재료물성분석<br>· 나노구조분석 | · 분자 모델링<br>· 유기/무기 화학분석<br>· 광분석 및 광표준화<br>· 유해물질분석<br>· Bio-Optics<br>· 고분자재료 분석평가 |
| 생산기술 | | · 공정설계기술<br>· 공정계측기술<br>· 산업공학<br>· 미세오염제어기술<br>· PKG기술 | · 광학설계기술<br>· 광센서 응용 | · 자동화제어기술<br>· 회로설계 | · 실장기술<br>· PKG기술<br>· 미세도금 | · 전해/무전해 도금기술<br>· 전기화학적 미세 회로 형성 도금 및<br>표면처리(PCB/Wafer)<br>· Micro Contaminination Control |